

壹、致股東報告書

於民國 110 年股東常會

各位股東女士、先生，大家好：

受惠於人工智慧、5G 通訊、物聯網、智慧駕駛和高速運算等先進科技的蓬勃發展，以及居家上班、遠距教學帶動個人電腦及電子終端產品強勁的需求，力成集團在半導體封測的營運，不管在記憶體或邏輯 IC 產品上都有著非常傑出的表現。2020 年我們的年營業額創下歷史新高，獲利金額也來到歷史次高。

展望 2021 年，我們認為封測產能的短缺現象將會持續，美中台緊張的情勢短期內應不會緩解，先進科技將會蓬勃發展並主導整個產業及市場趨勢。力成科技正站在這波世界變革、產業波動及技術升級的浪潮上，是我們改變現狀、轉型及追求永續成長的一個重要契機，因此我們採取以下的積極作為：

1. 組織改造：

持續引進先進技術工程人員與培育中高階主管，希望在精湛的製造基礎上加速先進封測技術的研發、製造及加強業務開發的能力。

2. 改善產品組合、分散客戶及繼續成長：

記憶體封測是力成的根本，力成將持續努力以維持記憶體封測世界第一的位置，與策略伙伴同步擴充產能，提升技術，共存共榮。且力成將以更積極及更努力的態度致力於邏輯及異質整合等先進技術及客戶的開發。

3. 整合集團資源，明確定位成為一站到位及全方位的國際半導體封測服務的領導廠商： 超豐—專注封測中低端產品，在生產技術、品質、成本、效率及服務領先業界，持續擴建產能以增加市佔率。

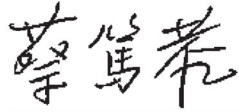
Tera Probe/晶兆成(Tera Power)—加強與日本、台灣、歐美等國際客戶合作，拓展邏輯晶圓及成品之測試服務。

力成科技—以既有的記憶體先進封測技術為基礎，積極拓展高階邏輯及異質整合的產品及客戶。

力成科技一直以來都被業界定位為記憶體封測服務的領導廠商，我要向各位股東報告，力成現在不只是記憶體封測外包服務(OSAT)世界第一，我們已成為半導體封測產業涵蓋邏輯產品服務的全方位公司。我們不僅以「成為世界封測服務最好的廠商之一」為目標，我們更要以「技術、品質及服務世界第一」為最終目標。

謝謝各位股東對力成集團全體員工及經營團隊的支持與鼓勵！

祝 大家身體健康，萬事如意

董事長： 
蔡篤恭

力成科技股份有限公司

一〇九年度營業報告書

一、109 年度營業報告書

根據國際貨幣基金組織(International Monetary Fund) 110 年 1 月之「世界經濟展望」報告指出，109 年上半年因新冠肺炎疫情之影響，全球經濟遭受前所未有的衝擊，各國為因應疫情，紛紛推出空前大規模的財政刺激政策、貨幣和監管措施，以維持家庭可支配收入、保障企業現金流量及支持信貸供給額；因此，已開發經濟體經濟負成長的程度不如預期嚴重，且中國大陸經濟復甦程度高於預期，預測下半年全球經濟衰退程度較上半年緩和，惟 109 年全球整體經濟成長率估計仍減少 3.5%。

在全球半導體的表現方面，根據國際研究暨顧問機構顧能(Gartner)調查結果顯示，因應疫情關係而採取的在家隔離措施，卻意外增加了在家上班和線上學習的遠距離工作商機，因而帶動整體半導體產品的需求，加上 5G 智慧型手機的滲透率提升，總計 109 年全球半導體產品營收為美金 4,498 億元，較 108 年增加 7.3%。在台灣半導體產業表現方面則明顯優於全球，工研院產科國際所於 110 年 2 月統計 109 年台灣 IC 產業產值達新台幣 32,222 億元(美金 1,089 億元)，較 108 年成長 20.9%，其中 IC 封裝業為新台幣 3,775 億元，較 108 年成長 9.0%，IC 測試業為新台幣 1,715 億元，較 108 年成長 11.1%。

本公司亦因新冠肺炎疫情而受惠，因為伺服器、筆記型電腦和行動終端產品等的需求提升，帶動整體業務成長，尤其在記憶體產品業務方面，表現優於全球及台灣半導體封裝測試產業，109 年全年度營收及獲利表現與去年比較有出現顯著的成長，並達成我們之前所設定的預期目標。未來我們仍將採取持續深耕技術、提供優良品質與服務並擴充產能以滿足客戶需求等方式來取得客戶的信賴，透過整合集團資源等方式來提高經營效率及降低成本，並積極研發新技術、開發新產品線、投資新設備以及強化策略夥伴聯盟等方式，來增加公司整體的競爭力。

茲將本公司 109 年度的營運成果報告如下：

(一)109 年度營業實施情形

本公司 109 年度合併營收為新台幣 761 億 8 仟 1 佰萬元，較 108 年度的新台幣 665 億 2 仟 5 佰萬元成長 14.51%；在盈餘方面，109 年度合併稅後純益中歸屬於母公司股東的金額為新台幣 66 億 6 仟 2 佰萬元，較 108 年度之淨利新台幣 58 億 3 仟 9 佰萬元成長 14.11%。

(二)財務收支情形

109 年度合併現金流量狀況：(單位：新台幣)

a.營業活動之現金淨流入	19,301,292 仟元
b.投資活動之現金淨流出	16,734,519 仟元
主要係取得不動產、廠房及設備	
c.籌資活動之現金淨流出	3,007,278 仟元
主要係配發股東現金股利及償還銀行借款	

(三)獲利能力分析

分析項目		年度	109 年度	108 年度
獲 利 能 力	營業利益 / 實收資本比率		137.56%	111.82%
	稅前純益 / 實收資本比率		133.41%	109.19%
	資產報酬率		7.78%	6.79%
	股東權益報酬率		14.44%	12.74%
	純益率		8.75%	8.78%
	每股純益		8.60 元	7.52 元

(四)研究發展狀況

本公司持續投入大量資源於新技術的研發與創新，109 年度研究及發展費用約為新台幣 21.96 億元，約占全年合併營收的 2.88%。在現有的記憶體及邏輯產品封測技術基礎下，積極開發先進封測及異質產品整合技術，包含覆晶封裝 (FC, Flip Chip)、系統級封裝 (SiP/SiM)、晶圓級封裝 (WLP, Wafer Level Package)、CMOS 影像感測器 (CMOS Image Sensor Chip Scale Package, CIS CSP)、2.5D/3D TSV 及扇出型面板級封裝 (FOPLP, Fan-Out Panel Level Package) 等封裝技術。目前已完成天線封裝 (AiP, Antenna in Package) 技術開發及射頻 (RF, Radio Frequency) 實驗室的建置，可提供 5G 封裝產品的驗證；在 CMOS 影像感測器 (CIS) 方面則運用既有高品質與高技術門檻的矽穿孔 (TSV) 技術，積極發展應用於醫療、監控及車用的晶圓級晶片尺寸封裝；扇出型面板級封裝 (FOPLP) 方面則與客戶密切進行相關產品的開發及驗證，提供客戶全方位的解決方案。

二、110 年度營業計劃概要

(一)經營方針

1. 重承諾 (Promise)、創新技術 (Technology) 及提供整合 (Integration) 服務為公司的核心價值。
2. 專注於半導體產品專業封裝及測試領域，與客戶及協力廠商共創利潤。
3. 致力於先進技術的研發及適時的導入新產品，以提高企業成長動能。
4. 以穩定的品質及精湛的技术提供客戶全方位的服務。
5. 整合資源及強化經營績效，確保企業的獲利與永續經營。
6. 培育人才及重視員工福利與股東權益，創造共享價值。

(二)預期銷售數量

世界半導體貿易統計 (WSTS, The World Semiconductor Trade Statistics) 預估 110 年全球半導體產品市場將持續成長，年增 8.4%，銷售額可達美金 4,694 億元。由工研院產科國際所的統計資料推估 110 年台灣 IC 產業產值約將成長 3.5%，達到美金 1,189 億元，顯示全球及台灣的半導體產業環境將可望持續成長。

依 IC Insights 資料，預估 110 年 IC 產業整體銷售額平均將上揚 12%。就 109 年全球十大半導體公司分析，記憶體與邏輯市場均較 108 年呈現大幅成長之勢。展望未來，隨著新興電子應用的興起，在人工智慧、5G、車輛輔助駕駛系統、資料中心、遠距教學及各式行動裝置的新功能推陳出新，預期半導體應用的領域與使用的數量在 110 年依然是持續成長。

在終端產品部分，受惠於 5G 需求帶動，集邦(TrendForce)預估 110 年全球手機之出貨量將成長至 13.6 億支，年成長 9%；Canalys 則預估全球個人電腦（包括桌機、筆電及平板）出貨量將因遠距工作及數位學習等因素成長至 4.64 億台，成長幅度為 1.4%。電子時報(DIGITIMES Research)預估伺服器市場受惠於遠距辦公及雲端服務需求，110 年將持續成長 5.6%，出貨量可達 1,700 萬台。

新冠肺炎(COVID-19)仍是影響各終端市場的最大不確定因素，市場復甦步伐的快慢取決於疫苗普及的速度。此外，因美國與中國間的貿易摩擦也將是影響整體產業發展的關鍵因素。

本公司預估在動態隨機記憶體(DRAM)、快閃記憶體(NAND Flash)、邏輯產品(Logic)及先進產品元件之銷售數量上將有所成長。

110 年預期銷售數量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約 150 億顆
測試	約 92 億顆
凸塊(Bumping)	約 98 萬片
晶圓測試	約 260 萬片
固態硬碟(SSD) + 薄型固態硬碟系統整合封裝(SIP)	約 1.4 億顆

(三)重要產銷政策

- 1.提供一元化(Turn-key)的客戶服務以縮短交期及降低總體成本。
- 2.提升記憶體產品封裝及測試的市場領先地位。
- 3.持續邏輯產品(Logic)業務之拓展，並積極加速覆晶封裝（FC, Flip Chip）、固態硬碟(SSD)、晶圓級封裝（WLP, Wafer Level Package）、晶圓級測試(CP)以及扇出型面板級封裝（FOPLP, Fan-Out Panel Level Package）的開發成長。
- 4.除了維持與現有客戶之長期合作關係，並積極拓展新市場、新應用、新客源及新產品的開發。
- 5.持續致力於產品的成本控制，充分利用並整合集團資源，以提升公司競爭優勢。

董事長：



經理人：



會計主管：

